

MEIKO REPORT

第51期 第2四半期 株主通信

(2025年4月1日から2025年9月30日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー

財務ハイライト

売上高

111,493 百万円

営業利益

11,418 百万円

親会社株主に帰属する中間純利益

9,395 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2025年3月31日現在	当第2四半期末 2025年9月30日現在
資産の部		
流動資産	114,112	139,716
固定資産	142,253	163,580
有形固定資産	129,570	147,458
無形固定資産	5,696	5,343
投資その他の資産	6,986	10,778
資産合計	256,366	303,296
負債の部		
流動負債	100,257	118,784
固定負債	40,502	60,817
負債合計	140,760	179,601
純資産の部		
株主資本	81,691	89,687
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	13,820	13,820
利益剰余金	57,649	65,639
自己株式	△2,666	△2,661
その他の包括利益累計額	26,547	26,554
その他有価証券評価差額金	92	141
繰延ヘッジ損益	50	3
為替換算調整勘定	26,322	26,330
退職給付に係る調整累計額	82	79
純資産合計	115,605	123,695
負債純資産合計	256,366	303,296

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2024年4月1日～ 2024年9月30日	当第2四半期(累計) 2025年4月1日～ 2025年9月30日
売上高	98,157	111,493
売上原価	79,223	88,460
売上総利益	18,934	23,032
販売費及び一般管理費	9,646	11,614
営業利益	9,287	11,418
営業外収益	699	949
営業外費用	1,981	1,007
経常利益	8,005	11,360
特別利益	72	1,092
特別損失	69	450
税金等調整前中間純利益	8,008	12,003
法人税等	1,588	2,521
中間純利益	6,419	9,481
非支配株主に帰属する中間純利益	86	86
親会社株主に帰属する中間純利益	6,333	9,395

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2024年4月1日～ 2024年9月30日	当第2四半期(累計) 2025年4月1日～ 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,442	13,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,175	△30,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,494	31,064
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,196	84
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	6,565	14,217
現金及び現金同等物の期首残高	21,363	22,913
現金及び現金同等物の中間期末残高	27,929	37,130

財務のポイント

●連結貸借対照表

- ・当中間連結会計期間末の総資産は303,296百万円となり、前連結会計年度末比46,930百万円増加。
- ・その主な要因は、流動資産では現金及び預金が15,556百万円増加、受取手形及び売掛金が6,069百万円増加、棚卸資産が2,841百万円増加、固定資産では有形固定資産が17,887百万円増加、投資その他の資産が3,792百万円増加。
- ・当中間連結会計期間末の負債は179,601百万円となり、前連結会計年度末比38,841百万円増加。

- ・その主な要因は、流動負債では支払手形及び買掛金が4,750百万円増加、短期借入金が5,132百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が7,036百万円増加、固定負債では長期借入金が20,613百万円増加。
- ・当中間連結会計期間末の純資産は123,695百万円となり、前連結会計年度末比8,089百万円増加。
- ・その主な要因は、利益剰余金が7,990百万円増加。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2025年度上期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2025年度上期 業績と通期業績予想

(単位：億円)

		2024年度		2025年度					
		上期実績	利益率	上期実績	利益率	下期予想	利益率	通期予想	利益率
売上高	基板	818		920		900		1,820	
	電子機器	164		195		215		410	
		982		1,115		1,115		2,230	
営業利益	基板	86	10.5%	100	10.9%	105	11.7%	205	11.3%
	電子機器	7	4.3%	14	7.2%	16	7.4%	30	7.3%
		93	9.5%	114	10.2%	121	10.9%	235	10.5%
	経常利益	80	8.1%	114	10.2%	106	9.5%	220	9.9%
	当期純利益	63	6.4%	94	8.4%	86	7.7%	180	8.1%
	期中平均為替レート (JPY/USD)	152.46		146.04		143.00		144.52	

2025年度上期 商品別売上実績

(単位：億円)

	2024年度		2025年度		前年同期比		前第1四半期比	
	上期	第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
車載	454	221	248	469	15	3.3%	27	12.2%
スマホ・タブレット	121	60	72	132	11	9.1%	12	20.0%
情報通信	89	48	70	118	29	32.6%	22	45.8%
半導体PKG基板	7	4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
モジュール基板	63	36	38	74	11	17.5%	2	5.6%
アミューズメント、スマート家電、産業機器、その他	84	58	58	116	32	38.1%	0	0.0%
EMS	85	45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
ODM	79	59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
電子機器	164	104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
合計	982	531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

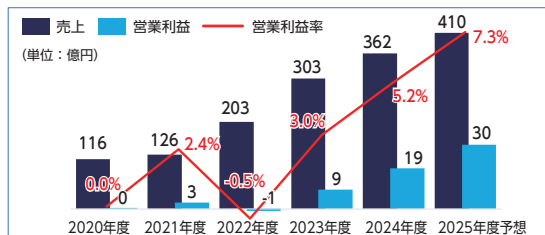
2025年度上期 仕様別売上実績

(単位：億円)

	2024年度		2025年度		前年同期比		前第1四半期比	
	上期	第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
4層板以下	221	102	109	211	-10	-4.5%	7	6.9%
6層板以下	166	84	91	175	9	5.4%	7	8.3%
多層貫通基板	387	186	200	386	-1	-0.3%	14	7.5%
8層板以下	250	114	150	264	14	5.6%	36	31.6%
10層板以下	147	113	120	233	86	58.5%	7	6.2%
ビルドアップ基板	397	227	270	497	100	25.2%	43	18.9%
半導体PKG基板	7	4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
リジッドフレキシ、フレキシ、炭素、大電流、その他	27	10	16	26	-1	-3.7%	6	60.0%
EMS	85	45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
ODM	79	59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
電子機器	164	104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
合計	982	531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

電子機器事業の取組について

当社の電子機器事業は、電子機器事業の強化を目的として、2022年度下期にメイコーエレクトロニクス株式会社をM&Aにより取得しました。これは、開発・設計を強化しより収益性の高い電子機器事業への取組の一環となります。これにより、ソフトウェア、電子回路、メカ、工場自動化技術を大幅に強化することができました。同時に、日本国内に実装・組立工場を取得したことにより、開発・設計にはじまり大規模量産まで対応する体制を構築しました。こうした取組を通じてより収益性が高い案件の開拓に取り組んだ結果、営業利益率を大幅に改善することができました。今後、更なる成長を加速するため需要が高まりつつある半導体実装への対応や、短納期試作ビジネス、新たな大規模量産に対応していく必要性が生じており、日本とベトナムに新工場を建設することといたしました。



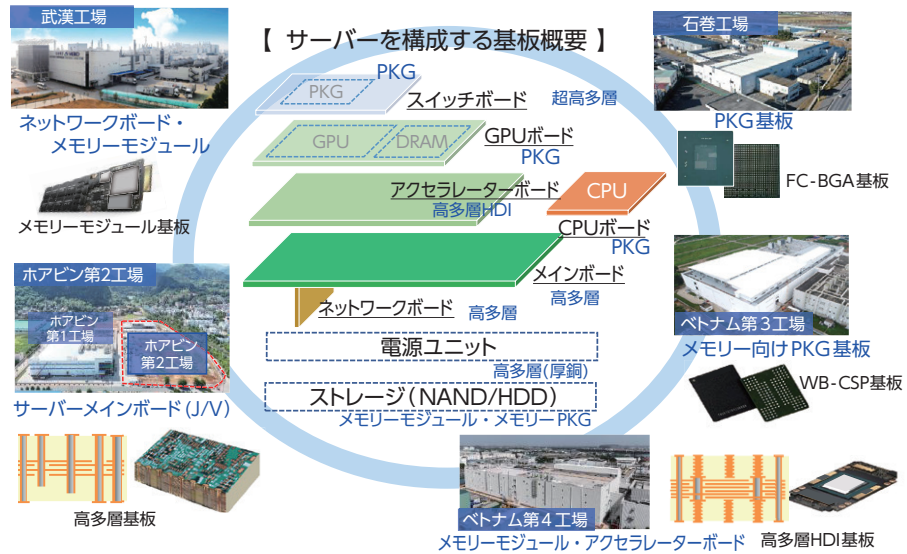
南陽工場第2工場 (今年10月に着工)	
敷地面積	約18,900㎡
延床面積	約4,700㎡
投資規模	約25億円
特徴	半導体実装にも対応した先端工場
稼働	2026年

ハイズオン第2工場 (5階建て工場兼倉庫)	
敷地面積	約40,000㎡
延床面積	約15,000㎡
投資規模	約20億円
特徴	実装と組立エリア
稼働	2027年

新規基板事業の取組について

AIサーバー向け各種基板の生産戦略

現在の電子部品業界を牽引する分野の1つにAIサーバーがあります。当社でもこれに使用されている電子回路基板をベトナムの各工場を中心に生産を開始する予定です。ベトナム第3工場では今期メモリー向けのパッケージ基板の生産を開始します。ベトナム第4工場では来期メモリモジュール基板、OAM基板(アクセラレータモジュール)の生産を行います。また、ACCL社との合併であるホアビン第2工場では2027年度よりメインボードの生産を行う予定です。生産基板と生産工場の関係は右図をご参照ください。



ACCL社との合併事業について

AIサーバー向けの需要増を見込みACCL社との提携により高多層分野に進出することといたしました。

ACCL社とのJV会社概要

企業名	Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.
出資比率	ACCL70%、Meiko30%
設立	2025年11月
場所	ホアビン第2工場(延床:60,000㎡)
生産開始	2027年から順次開始予定
事業内容	AIサーバー向け高多層基板

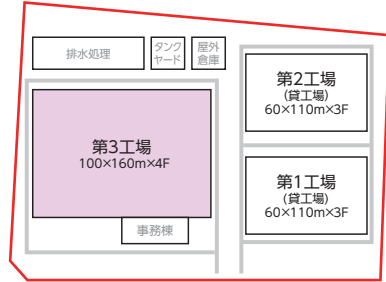


ベトナム新工場の検討について

ベトナムにおけるビルドアップ基板の需要拡大に対応するため新工場の建設を検討してまいります。

クアンミン第3工場事業概要

敷地面積	約63,000㎡
延床面積	約53,000㎡(第3工場)
投資規模	約400億円
事業内容	最先端高密度ビルドアップ基板



天童開発センターについて

新技術、新商品の事業化を促進するため天童開発センターを開設することといたしました。

天童開発センターの狙い

産学連携開発案件強化
米沢 ODM 事業との連携
新規開発商品の量産化
部品内蔵基板の量産化



部品内蔵基板



株主還元について

当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重点課題の一つとしております。当面は、企業規模拡大のための投資を優先し、売上と利益額の拡大に注力いたします。配当性向の目安を15%とし、利益額の拡大とともに配当額の増加を図ってまいります。

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります所存です。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

1株当たり配当金の推移

(単位: 円)

	2023年度	2024年度	2025年度
中間	27	40	45
期末	41	48	45(予想)
合計	68	88	90(予想)



取締役専務執行役員
和田 純也

2025年度上半期はトランプ関税による需要への影響が懸念されましたが、当社売上、利益とも前年同期比2桁増と大きく伸長する事が出来ました。

為替(円安、元安)による押し上げ効果もありましたが、ゲーム等のアミューズメント向け、情報通信向け基板が好調に推移し、また電子機器事業もODM事業中心に大きく伸ばす事が出来ております。

当社は昨年創業50周年を迎え、新たな50年に向けスタートしていますが、この上期にはベトナム ホアビン工場竣工、ベトナム第4工場竣工と、更なる需要に向けた投資を実施しています。

今後も地政学リスクからアセアン地区への生産ニーズが高まる中、当社としてベトナム拠点を受け皿として積極投資を続け、一方日本国内生産ニーズに対しても天童工場を中心に、顧客のサプライチェーンニーズに対応してまいります。

収益改善に対してはグローバル資材の導入による変動費の低減、自動化による省人化、省エネ改善等を中心に実施し、お客様のニーズに応える高品質な商品を提供してまいります。

現在、AI技術が急激に拡大しており、AIサーバーの需要は基板においては信号の高速伝送化、高多層化となり高多層高速基板の需要は今後一層拡大していくと予想されています。弊社においてもこれまで培ってきた設計・プロセス技術を最大限活用し対応してまいりたいと思います。

今後とも引き続きのご支援を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

コーポレートデータ (2025年9月30日現在)

会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	13,849名(連結) (国内1,430名・海外12,419名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

役員

代表取締役社長執行役員	名 屋 佑 一 郎
代表取締役副社長執行役員	坂 手 敦
取締役専務執行役員	和 田 純 也
取締役常務執行役員	桔 梗 芳 人
取締役常務執行役員	名 屋 茂
取締役	土 屋 奈 生
取締役	西 山 洋 介
取締役	原 田 隆
取締役	小 林 俊 文
常勤監査役	松 田 孝 広
監査役	江 尻 琴 美
監査役	橋 本 真 一

関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社宮城メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
メイコーエレクトロニクス株式会社	電子関連事業
メイコーエレクトロニクス株式会社	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
広州市斯皮德貿易有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hoa Binh Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hai Duong Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業

株主情報

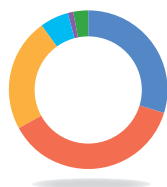
発行可能株式総数	普通株式	70,000,000株
	第一回社債型種類株式	100株
発行済株式の総数	普通株式	26,000,612株
	(自己株式 802,708株を除く)	
	第一回社債型種類株式	70株
株主数	普通株式	3,227名
	第一回社債型種類株式	1名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,075	15.67
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3,451	13.27
CLEARSTREAM BANKING S.A.	975	3.75
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	653	2.51
名幸興産株式会社	608	2.34
有限会社ユーホー	521	2.00
株式会社三井住友銀行	377	1.45
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)	312	1.20
JP MORGAN CHASE BANK 385632	302	1.16

※当社は、自己株式802,708株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況



個人・その他	29.81%
金融機関	37.30%
外国法人等	22.98%
その他の法人	5.83%
金融商品取引業者	1.09%
自己名義	2.99%

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。